

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Seite/Page
 1 / 4

Part Number

5112.HSD.1X10.00Z

Teilenummer

Description

**HSD PCB Anbaustecker
 HSD PCB mount plug**

Beschreibung



Design according to

Ausführung nach

Electrical characteristics / Elektrische Eigenschaften

	colored value means: still under test target value			
		Value/Wert	Unit/Einheit	
Impedance (MIL-C-39012B)		100 ± 10%	[Ω]	Impedanz (MIL-C-39012B)
Operating frequency up to		5	[GHz]	Betriebsfrequenz bis zu
Return loss	DC - 1GHz	≥ 30	[dB]	Rückflusssdämpfung
	DC - 2GHz	≥ 18	[dB]	
	DC - 5GHz	≥ 10	[dB]	
Insertion loss	DC - 1GHz	≤ 0,1	[dB]	Einfügedämpfung
Nearend crosstalk	DC - 3GHz	≥ 40	[dB]	Übersprechen nahes Ende
	DC - 5GHz	≥ 30	[dB]	
Farend crosstalk	DC - 3GHz	≥ 40	[dB]	Übersprechen fernes Ende
	DC - 5GHz	≥ 35	[dB]	
Skew (between wire pairs)		≤ 5	[psec]	Laufzeitdifferenz zwisch. Adernpaaren
RF Leakage	DC - 1GHz	≥ 75	[dB]	Schirmdämpfung
	DC - 2GHz	≥ 65	[dB]	
Insulation resistance		≥ 1x 10 ³	[MΩ]	Isolationswiderstand
Contact resistance				Kontakt-Widerstand
Centre contact		≤ 10	[mΩ]	Innenkontakt
Outer contact		≤ 7,5	[mΩ]	Außenkontakt
Contact current max. (DC)		≤ 1,5	[A] DC	Kontakt-Strombelastbarkeit max (DC)
Operating voltage		max. 100	[V] DC	Betriebsspannung
Proof voltage		500	[V] eff	Prüfspannung

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

		Value/ Wert	Unit/Einheit	
Engagement force		≤ 30	[N]	Steckkraft
Separating force		≥ 5	[N]	Ziehkraft
Mating cycles		≥ 25		Steckzyklen
Coding efficiency		≥ 80	[N]	Kodierungseffizienz
Retention force locked system		≥ 110	[N]	Bauteilfestigkeit

Date/Generated: 26.05.2015 / M.Imtiaz
 Date/Approved: 23.06.2015 / MF/MB/MI

Revision c

Date/Approved: 23.06.2015 / MF/MB/MI

Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Seite/Page
3 / 4

Part Number

5112.HSD.1X10.00Z

Teilenummer

Description

**HSD PCB Anbaustecker
HSD PCB mount plug**

Beschreibung

Soldering process / Lötprozess

Soldering methode/

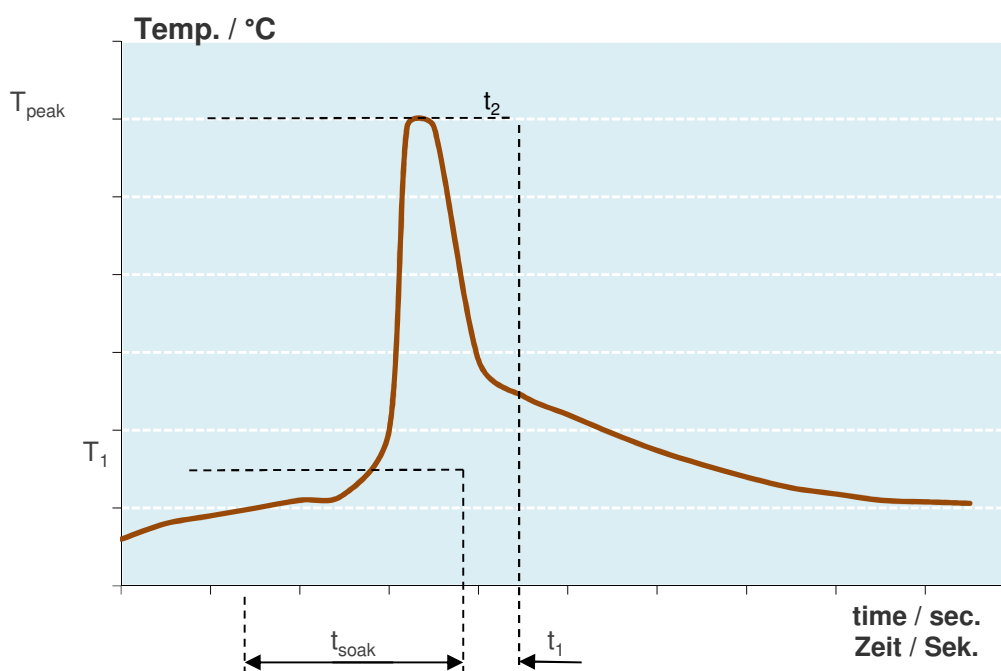
THT - Wavebath solderability / Wellenlötbad

Lötmethode:

Recommended wave soldering profile /

Empfohlenes Lötprofil (Wellenbad):

Parameter	Reference	Specification
Temperature gradient in preheating / Temperaturgradienten in Vorwärmen		2°C/s max.
Soak time / Setzzeit	t_{soak}	< 30 seconds
Preheat temperature/Temperatur vorheizen	T_1	< 100° (-5/+5)°C
Temperature gradient time/ Temperaturgefälle (Zeit)	t_1	5-6 second
Soldering time / Lötdauer	t_2	10 Seconds max.
Peak temperature / Spitzentemperatur	T_{peak}	300°C max.
Temperature gradient in cooling/ Temperaturgradienten in Kühlung		6°C/Seconds max.



Product Data Sheet / Produkt Datenblatt

Seite/Page
 4 / 4

Part Number

5112.HSD.1X10.00Z

Teilenummer

Description

**HSD PCB Anbaustecker
 HSD PCB mount plug**

Beschreibung

Soldering process / Lötprozess

Soldering methode /

THR / Reflow

Lötmethode:

Recommended reflow soldering profil /

Empfohlenes reflow Lötprofil:

Parameter	Reference	Specification
Max. Temperature (lead free soldering) Max. Temperatur (bleifreies Löten)	C°	260°

